

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第3区分

【発行日】平成17年11月4日(2005.11.4)

【公開番号】特開2000-158341(P2000-158341A)

【公開日】平成12年6月13日(2000.6.13)

【出願番号】特願平10-337685

【国際特許分類第7版】

B 2 4 B 57/02

H 0 1 L 21/304

【F I】

B 2 4 B 57/02

H 0 1 L 21/304 6 2 2 E

H 0 1 L 21/304 6 2 2 D

【手続補正書】

【提出日】平成17年8月15日(2005.8.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

研磨スラリーを用いて被加工物を研磨する研磨方法において、

前記研磨スラリーを不活性ガス雰囲気で貯留することを特徴とする研磨方法。

【請求項2】

前記研磨スラリーは、酸化セリウムスラリーであることを特徴とする請求項1に記載の研磨方法。

【請求項3】

使用済みの前記研磨スラリーを再利用することを特徴とする請求項1または2に記載の研磨方法。

【請求項4】

前記被加工物は、SiN膜上に形成されたSiO<sub>2</sub>膜であり、

前記研磨スラリーをpH7以下に保つことを特徴とする請求項1, 2または3に記載の研磨方法。

【請求項5】

研磨スラリーを用いて被加工物を研磨する研磨装置と；

前記研磨装置に供給する研磨スラリーを貯留するタンクと；

前記タンクに不活性ガスを供給する不活性ガス供給機構とを備えることを特徴とする研磨システム。

【請求項6】

前記タンクは、新規な研磨スラリーを貯留する貯留槽と；前記研磨装置において使用された使用済みの研磨スラリーを回収、再生する回収槽と；前記貯留槽と回収槽から供給されるスラリーを混合して前記研磨装置に供給する供給槽とを含むことを特徴とする請求項5に記載の研磨システム。

【請求項7】

前記研磨スラリーは、酸化セリウムスラリーであることを特徴とする請求項5または6に記載の研磨システム。

【請求項8】

前記研磨装置は、SiN膜上に形成されたSiO<sub>2</sub>膜を研磨するものであり、

前記研磨スラリーをpH7以下に保つことを特徴とする請求項5, 6または7に記載の研磨システム。

【請求項9】

前記研磨装置は、前記被加工物の研磨面付近に前記不活性ガスを導くノズルを備え、

前記不活性ガス供給機構は、前記研磨装置のノズルに前記不活性ガスを供給することを特徴とする請求項5, 6, 7または8に記載の研磨システム。

【請求項10】

研磨スラリーを用いて被加工物を研磨する研磨装置において、

前記研磨スラリーを不活性ガス雰囲気で貯留する工程を実施することを特徴とする研磨システム。

【請求項11】

前記研磨スラリーは、酸化セリウムスラリーであることを特徴とする請求項10に記載の研磨システム。

【請求項12】

使用済みの前記研磨スラリーを再利用することを特徴とする請求項10または11に記載の研磨システム。

【請求項13】

前記被加工物は、SiN膜上に形成されたSiO<sub>2</sub>膜であり、

前記研磨スラリーをpH7以下に保つことを特徴とする請求項10, 11または12に記載の研磨システム。